OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

ERISTÄVÄT LIIMAT / NON-CONDUCTIVE ADHESIVES

LOCTITE®

449628
LOCTITE ABLESTIK QMI536 10ML



- Nopeasti kovettuvat liimat
- UV-kovetteiset liimat
- Yleisliimat
- Huoneenlämpökovetteiset liimat
- 2-komponenttiliimat

TUOTEKUVAUS

LOCTITE ABLESTIK QMI536 ja QMI546 ovat sähköä eristäviä die attach -liimoja puolijohdekomponenttien ja integroitujen piirien kiinnittämiseen. Tuotteet soveltuvat muun muassa PBGA- ja CSP-rakenteisiin, pinottuihin siruihin sekä muihin edistyneisiin puolijohdepaketteihin, joissa liimasaumalta vaaditaan sähköistä eristystä ja hallittua mekaanista käyttäytymistä.

Liimat perustuvat fluoropolymeeritäytteiseen bismaleimidi- eli BMI-kemiaan. Materiaalit ovat hydrofobisia ja niiden dielektriset ominaisuudet ovat hyvät. Kovettunut liimasauma kestää korkeita lämpötiloja, ja materiaalien koostumus on suunniteltu vähentämään huokosten muodostumista liimasaumaan.

LOCTITE ABLESTIK QMI536 tarttuu useisiin puolijohdepakkausten orgaanisiin ja metallisiin pintoihin, kuten juotosmaskiin, BT- ja FR-materiaaleihin, polyimidiin ja kultaan. Sen kovettuminen alkaa alle +100 °C:ssa, mikä voi vähentää orgaanisten alustojen esikuivauksen tarvetta. Suositeltu SkipCure-prosessi on vähintään 10 sekuntia +150 °C:ssa, ja materiaali voidaan kovettaa myös kiertoilmauunissa noin 15 minuutissa +150 °C:ssa.

LOCTITE ABLESTIK QMI546 on kehitetty erityisesti nopeaan die attach -prosessiin. Materiaali kovettuu nopeasti veden kiehumispisteen alapuolella, mikä auttaa ehkäisemään höyryn aiheuttamien huokosten muodostumista. Valmistajan ilmoittama SkipCure-kovetus on vähintään 8 sekuntia +150 °C:ssa.

QMI536:n viskositeetti on noin 8 500 mPa·s ja QMI546:n noin 6 500 mPa·s lämpötilassa +25 °C. Molempien tilavuusresistiivisyys on yli 1×10^{13} Ω·cm ja dielektrisyysvakio 2,6 lämpötilassa +25 °C ja taajuudella 1 MHz. Materiaalin valinnassa on huomioitava komponenttirakenne, liimasauman paksuus, alusta ja käytettävä kovetusprosessi.